



【東京/武蔵村山】品質保証リーダー候補 ◆ヤマハ発動機グループ

ヤマハロボティクス株式会社での募集です。品質管理・品質保証（技術系）のご経験...

## Job Information

### Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

### Hiring Company

ヤマハロボティクス株式会社

### Job ID

1592503

### Industry

Electronics, Semiconductor

### Job Type

Permanent Full-time

### Location

Tokyo - Other Areas

### Salary

4.5 million yen ~ 7.5 million yen

### Work Hours

08:45 ~ 17:30

### Holidays

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 初年度 採用月に応じて2日～15日 1か月目から 【休日】完全週休二日制 土日...

### Refreshed

May 14th, 2026 16:03

## General Requirements

### Career Level

Mid Career

### Minimum English Level

Daily Conversation

### Minimum Japanese Level

Native

### Minimum Education Level

Technical/Vocational College

### Visa Status

Permission to work in Japan required

## Job Description

【求人No NJB2335254】

■組織構成：組織：品質保証部

### ■業務内容

品質不具合対応、再発未然防止、信頼性評価など、品質保証業務全般を担当いただきます。  
1.市場および自社内品質不具合の一次故障解析と再発・未然防止実施までのフォローアップ  
2.監査を含む協力会社（日本国内および海外サプライヤ）の品質管理

- 3.新規開発品の品質・信頼性評価およびDR（デザインレビュー）を含む開発ゲート管理
- 4.品質情報のデジタル化推進およびデータ活用による品質改善
- 5.品質マネジメントシステム（QMS）の更新・維持・管理

#### ■半導体ボンディング装置のパイオニア企業

1970年代後半、それまで人の手で行われていたワイヤボンディング（半導体製造における後工程作業）の全自動化に成功したのは当社です。競合が増えた今、当社の強みは品質No.1であり仕様に沿ってカスタマイズ設計ができること。この丁寧さは今後も捨てずに、日本企業としての自信・自負をもって世界No.1であり続けるのが私たちの目標です。

#### [取扱い製品]

ワイヤボンダ、ダイボンダ、パンプボンダ、フリップチップボンダ、等

#### □主力製品「フリップチップボンダ」について

半導体製造のための精密ロボットです。  
ウェハー上に形成された半導体素子を、反転（フリップ）させて基板上  
もしくはウェハー上へボンディングする為の装置で、従来のワイヤボンディングに  
替わる新しい実装技術になります。  
最新のスマートフォンやデータセンタの中心的な役割を果たすICを  
製造する為の装置です。  
メカトロニクス技術はもちろん、制振制御、ロボティクス、材料工学、  
画像処理技術などあらゆる最先端の技術がつまっています。

---

### Required Skills

#### ■必須（主務クラスに求めている内容）

- ・機械系メーカーでの品質保証経験
- ・以下のいずれかのご経験  
故障解析～再発・未然防止/サプライヤ管理/信頼性評価/DR/品質情報管理のDX化/QMSの維持管理

#### ■尚可（主務クラスに求めている内容）

- ・マネジメント経験や社内および協力会社への品質改善指導経験

---

### Company Description

ヤマハロボティクス株式会社（Yamaha Robotics Co. Ltd.）は、ヤマハ発動機株式会社グループにおいて半導体製造装置（後工程）および電子部品組み立て装置事業を担う会社です。